

LCP 日本东丽 LX70G35连接器专用LCP塑胶原料诚信合作

产品名称	LCP 日本东丽 LX70G35连接器专用LCP塑胶原料诚信合作
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

良好的加工性 各种塑料制品都是由熔融塑料用成型机成型的，由于树脂的熔点都较低，易于熔融，将熔料注射入模具中，在很短的时间内即可制成形状复杂，尺寸稳定、质量优良的塑料制品。

POM塑胶原料系列可注塑成型，挤出成型，压缩成型，滚塑成型，吹塑成型。应用于齿轮，链轮，滑轮，滑轨，弹簧，支架，卫浴，阀门，导轨，剃须刀，水，夹子，电动牙刷，插座，开关零件，燃油系统部件，玩具，洗衣机，轴承，工具把手，密封垫，淋浴喷头，外壳，座椅安全带扣，拉链，卡扣，纽扣，板材，杆，板料，结构部件和机加工。

力学性能好 塑胶原料的力学性能相对于金属要差些，但是塑料比金属要轻很多，因此按单位质量计算的强度（又称比强度）要接近或超过传统的金属材料，而某些塑胶原料，如玻璃钢的比强度比钢要高很多，因此，可以利用塑胶原料制作许多结构性构件。

通用塑料这类塑料时一类用途十分广泛的塑料，它产量大，约占塑料总产量的四分之三，价格低，大量用来制作受力不大的日用品，如电视机外壳、电话机外壳、塑料盆、塑料桶等。与人们的关系十分密切，成为塑料工业的重要支柱。常用的通用塑料有PE、PVC、PS、PP、PF、UF、MF等。

ADMER QF300E是一种马来酸酐接枝、均聚聚丙烯（homo PP）基胶粘剂树脂，在与PP和PA的流延膜应用中具有良好的加工性能。

本公司品种，货源充足，产品原厂原包，，批量采购，原料可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉，诚信的合作”方针；“客户至上，品质为本”是我们的准则；“为客户降低生产成本，”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如需其它型号请来电咨询洽谈！

LCP塑胶原料全称LIQUID CRYSTAL POLYMER，中文名称液晶聚合物。

绝缘材料：PEEK因具有优良的电气性能，在高温、高湿等恶劣条件下，聚醚醚酮的绝缘性能仍能保持，是理想的电绝缘材料，特别是在半导体工业中得到广泛应用。

LCP液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变缺点，液晶材料可忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。

LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。LCP塑胶原料是防火安全性好的特种塑料之一。

塑胶原料的力学性能通常比金属低的多,但有的复合材料的比强度和比模量高于金属,如果制品设计合理,会更能发挥起优越性;

ADMER QE800E是一种马来酸酐接枝的高纯度聚丙烯浓缩物，于PP、EVOH、PA、木材、纸张和玻璃纤维的化合物中用作偶联剂和相容剂。添加到基体聚合物中，可改善木塑复合材料、阻燃电线电缆化合物和注塑件的机械性能。

PEEK是一种具有耐高温、耐腐蚀、高强度、高精度、自润滑、耐磨损、耐水解、良好的生物相容性等特性优点的聚芳醚酮类特种高分子聚合物。具有良好的加工成型特性，可以采用注塑、连续挤出、模压、预浸、机加工、粉末涂覆、焊接、粘接、表面金属化及3D打印等成熟工艺进行加工成型。

具有良好的耐辐射照性和化学稳定性，故常用于原子能工业密封材料和仪表零部件。它可加工成形状复杂的制品，薄而口径大的管、薄片、薄膜、电线包皮、热收缩管和化工设备衬里等。

LCP塑胶原料的特性；

a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。

b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。

c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。

d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。

e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。

b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。

c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。